



**Процесс ОЗП 900** заключается в нанесении финишного покрытия на контактные площадки печатных плат, не закрытые маской. Покрытие обеспечивает плоскостность контактных площадок, необходимую для автоматического поверхностного монтажа компонентов. По термической устойчивости покрытие может быть использовано в технологии смешанного монтажа.

**Покрытие ОЗП обеспечивает** сохранение параметров печатных плат в соответствии с ГОСТ 23752.

**Процесс ОЗП 900** является альтернативой горячему лужению.

[Техническая консультация](#)

#### Основные этапы процесса ОЗП 900:

| № | Операция                            | Температура, °С | Время обработки, мин. | Примечание  |
|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 1 | Очистка (ОЗП 901)                   | 20 — 30         | 2-4                   | Эффективно удаляются загрязнения с поверхности заготовки, не оказывая агрессивного воздействия на маску и металлические покрытия на плате.  |
| 2 | Микротравление (ОЗП 902)            | 20 — 25         | 1-2                   | Обновляется поверхность меди стравливанием слоя толщиной 1- 2 мкм.<br>Получаемая структура поверхности меди максимально эффективна для последующего нанесения органического защитного покрытия. |
| 3 | Декапирование в 10% соляной кислоте | 18 — 25         | 0.3-0.5               | Активирование поверхности меди перед нанесением органического покрытия.   |



|   |                              |         |   |  |
|---|------------------------------|---------|---|--|
| 4 | Нанесение покрытия (ОЗП 904) | 38 — 43 | 1 | Производится в водном растворе при невысокой температуре, не воздействуя термоударом на платы. |
|---|------------------------------|---------|---|--|

По вопросам приобретения **Органическое защитное покрытие ОЗП 900** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: